

# 300mm Tape Frame PI & C TF Activities Report

**April 18, 2019**

Hisashi Goto/ Sony Semiconductor Solutions Corporation

Naomune Taniguchi/ Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

# 1 参加者リスト / Attendees list

	Name	Company
1	Kenichi Hirose	ACHILLES Corporation
2	Takara Ichikawa	ACHILLES Corporation
3	Shoji Komatsu	Acteon NEXT, LLC
4	Nobuo Matsuki	CANON ANELVA CORPORATION
5	Masami Shibagaki	CANON ANELVA CORPORATION
6	Kenji Yamagata	DAIFUKU CO.,LTD
7	Tomoko Suzuki	DAIFUKU CO.,LTD
8	Akihiko Tomochika	DISCO Corporation
9	Yoshiaki Hirabayashi	DISCO Corporation
10	Sumio Masuchi	DISCO Corporation
11	Kyosuke Kobinata	DISCO Corporation
12	Akihito Kawai	DISCO Corporation
13	Yukio Takeda	DISCO Corporation
14	Noriyoshi Toyoda	Hirata Corporation
15	Hirofumi Nakamura	Hirata Corporation
16	Koichi Tsunobuchi	KEYENCE Corporation
17	Gen-ichirou Kamiyama	Lasertec Corporation
18	Hidemasa Uezono	Lasertec Corporation
19	Hiroyuki Yoshida	Lasertec Corporation
20	Atsushi Uemichi	LINTEC Corporation
21	Tsuyoshi Nagashima	Miraial Co., Ltd.
22	Teppei Miho	Miraial Co., Ltd.
23	Yasuhisa Ito	MURATA MACHINERY, LTD.
24	Tadamasa Tominaga	MURATA MACHINERY, LTD.
25	Poshin Lee	Entegris Asia LLC, Taiwan Branch

	Name	Company
26	Kyoji Dantani	Nihon Entegris K.K.
27	Kazushige Iwatake	Nihon Entegris K.K.
28	Chieko Akutagawa	Nihon Entegris K.K.
29	Kazuo Yasuda	SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.
30	Kunihiko Segawa	SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.
31	Koji Hada	SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.
32	Hiroyuki Shida	Shin-Etsu Polymer
33	Tsukasa Fukunaga	Shin-Etsu Polymer
34	Mikio Otani	SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD
35	Yasushi Taniyama	SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD
36	Atsushi Suzuki	SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD
37	Hayato Iwamoto	Sony Semiconductor Solutions
38	Yoshiya Hagimoto	Sony Semiconductor Solutions
39	Hisashi Goto	Sony Semiconductor Solutions
40	Tsutomu Okabe	TDK Corporation
41	Kiyoshi Kanashiro	TDK Corporation
42	Takuo Kawauchi	Tokyo Electron
43	Supika Mashiro	Tokyo Electron
44	Masayuki Azuma	TOKYO SEIMITSU CO., LTD.
45	Naomune Taniguchi	TOKYO SEIMITSU CO., LTD.
46	Yusuke Arai	TOKYO SEIMITSU CO., LTD.
47	Taichi Fujita	TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

## 2 活動実績 / Results of Activities

- ・12月14日のPI&C会議以降、以下の日程でTF会議を開催した。

After PI&C Japan meeting on 14<sup>th</sup> Dec, we held TF meetings on the date below.

- 5回目：2018年12月14日（金）, 14:00～16:00, 場所：東京ビッグサイト国際会議棟703
- 6回目：2019年01月30日（水）, 14:00～16:00, 場所：SEMI 市ヶ谷
- 7回目：2019年03月01日（金）, 14:00～16:00, 場所：TEL熊本クラブ
- 8回目：2019年03月29日（金）, 14:00～17:30, 場所：SEMI 市ヶ谷

### 3 ピッチ寸法とスロット数の決定と新容器・ロードポート規格着手

/ Decision of the pitch size and number of slot, Creation of Specification

・450mm FOUP規格化のピッチ寸法決定プロセスを踏襲し、新容器(300mm Frame FOUP)のピッチ寸法を決定する事とした。

We determined the pitch of 300mm Frame FOUP, using the method of the process of 450mm FOUP.

・検討の結果としてピッチは20mmとした。

また現実的なカセットサイズからスロット数を13とすると決定した。

We reached a decision in regards to the value of pitch is 20mm, the number of slot is 13.

・ピッチとスロット数の決定により、容器メーカーで新容器の概要検討を進めることが可能になったため、メーカー間で規格の素案に着手した。またロードポートも同様に進める。

By decision of the pitch size and number of slot , designing outline of new cassette can be proceed.

Therefore container manufactures started to prepare the draft of specification.

The draft of specification of loadport would be started to prepare as well.

## 4 容器メーカーからのフィードバック

/ Discussion about the feedback from container manufactures

- ・2/21にSEMI ESG Carrier Sub-Group会議が開催、  
そこで新容器について議論が持たれタスクフォースへ意見があった。

そのフィードバックに対しタスクフォース内で議論した。

SEMI ESG Carrier Sub-Group meeting was held on 21<sup>st</sup> Feb.  
They discussed 300mm Frame FOUP and gave us feedback.  
We discussed and concluded them in TF meeting.

- ・取り上げたトピックスは以下：

The topics we discussed are as follows:

### 1) Tape Frame FOUPのTOP/SIDE/BOTTOM/DOOR, そしてInteriorに設定すべき物

Proposed requirements/option for 300m Frame FOUP

### 2) 300mm Tape Frame FOUPを規格化するにあたり、従来の規格を使用する物と新規に制定する項目とを明確にした。

We checked the related Standard and listed the item to establish the standard for 300mm Frame FOUP .

## 5 SNARFのレビュー / SNARF Review

### 5.1 ロードポート部のSNARFドラフトのレビューが行われた

We reviewed and revised SNARF regarding loadport.

- ・ロードポート部に関しては以下4点のSNARFを発行。

We submitted four SNARF.

#### 1) ロードポートに関する寸法上の要求事項に関するSNARF (E15.1に相当)

SPECIFICATION FOR 300mm TAPE FRAME FOUP LOAD PORT

#### 2) フロントオープニング・ボックスとのインタフェースについての要求事項に関するSNARF(E62に相当)

SPECIFICATION FOR FRONT OPENING INTERFACE BETWEEN 300mm TAPE FRAME FOUP AND LOAD PORT

#### 3) ボックスオープナ/ローダーとの装置間のスタンダード (BOLTS-M) (E63に相当)

SPECIFICATION FOR BOLTS OF 300mm TAPE FRAME FOUP LOAD PORT

#### 4) ロードポート状態表示器及び操作スイッチの設置についてのSNARF (E110に相当)

SPECIFICATION FOR INDICATOR PLACEMENT ZONE AND SWITCH PLACEMENT VOLUME  
OF 300mm TAPE FRAME FOUP LOAD PORT

### 5.2 新容器のSNARFドラフトのレビューが行われた

We reviewed and revised SNARF regarding 300mm Tape Frame FOUP.

- ・次のSNARFを発行。 We submitted four SNARF

#### 1) New Standard - SPECIFICATION FOR 300mm TAPE FRAME FOUP

## 6 今後の活動予定 / Next Actions

- ・今回検討されたSNARFの予定は以下。

4/3 : SNARF案 SEMI ジャパン事務局へ提出

4/4～17 : TC メンバーへ配布& Review

4/18 : PIC委員会へ SNARF 提出

- 今後TF日程（予定）

– 9回目 : 2019年 5月16日（木） 10:00～ 場所 : SEMI ジャパン 市ヶ谷

## 7 SNARF配布後のフィードバック /Feedbacks to five SNARFs distributed for 2 weeks TC member Review

- Rao Nagesh / Safe Techno  
Thanks for below SNRF information. No Comments on below items.
- Matt Fuller / Entegris  
I have no additional feedback.
- Shoji Komatsu / Acteon NEXT  
SNARF案について、2点質問があります。  
ロードポートスタンダードはなぜ一つにまとめないのですか？  
K Cピン形状・配置(E57相当)はどのスタンダードに含まれますか？  
本件、4月18日のPIC-TCで確認できればと考えています。
- Rafael Vargas-Bernal / Instituto Tecnológico Superior de Irapuato  
I consider that all these new standards must be developed.



## 8 その他の連絡事項 / Other information

- 東京精密 東は海外支店へ異動したため、コ・リーダーから退任。

Co-Leader Mr. Azuma(TOKYO SEIMITSU) resigned because he transferred to the overseas branch.